



深圳市凯越翔电子有限公司

贴片晶振规格书

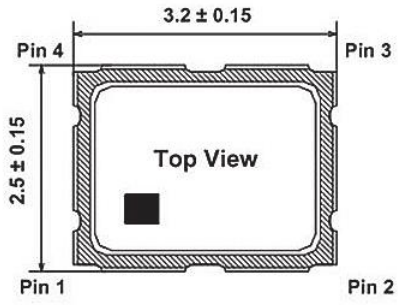
产品名称:	贴片晶振
产品型号:	3225/24.000 MHZ
产品参数:	1.8V-3.3V/±30ppm
原厂型号:	K3A240003.330
凯越翔技术部:	董宗全
客 户 确 认 栏	
认 证 印 章 年 月 日	负 责 人 印 章 年 月 日

本规格章程连同本页共 4 页

一、技术规范 (Specifications)

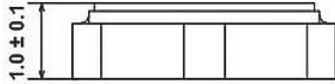
标称频率 Normal Freq.	24.000 MHz		工作电压 Vs	1.8V~3.3V/±5%	
频率 特性 Frequency Specialty	准确度 Frequency Tolerance	≤ ±30PPm	波形 特性 Waveform Specialty	输出波形 Wave form	方波 square wave
	频率温度稳定度 Frequency-Temp Stability	≤ ±20PPm		输出幅度 Output voltage	≤ 1.8~3.3V
	频率负载稳定度 Frequency-Load Stability	≤ ±1PPm		上升时间 Rise time	≤8nS
	电源电压稳定度 Frequency-Vs Stability	≤ ±2PPm		下降时间 Fall time	≤8nS
老化 aging	老化/日 aging/day			占控比 Duty	45%~55%
	老化/年 aging/year	≤ ±3PPm		输出阻抗 Output Impedance	1K Ω //15PF
谐波抑制 Harmonic			相位噪声 SSB Noise		
杂波抑制 Spurious					
封装形式 Package	SMD 3225		牵引范围 Pulling Rang		
温度范围 Temperature Range	操作温度范围 Operating Temperature	-40°C~+85°C	电流 Current	≤30mA	
	储存温度范围 Storage Temperature	-40°C~+85°C	其它 Else		

二.

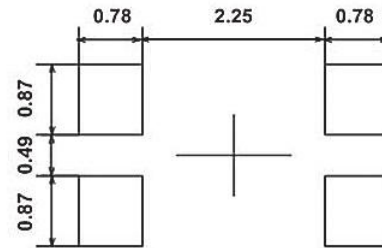
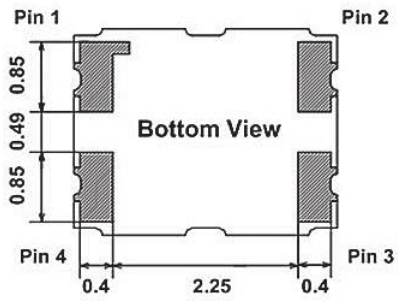


Pin Connection

Name	Connection
Pin 1	AFC or GND
Pin 2	GND
Pin 3	OUTPUT
Pin 4	VCC



Recommended Land Pattern



三、可靠性测试方法 (Reliability testing method)

凯越翔晶振

凯越翔晶振

凯越翔晶振

项目 (Items)	内容 (Contents)	要求 Requirements			
振动 Vibrating	振动频率：从10HZ到55HZ,再回到10HZ, 1倍频程/min, 幅度为1.5mm, 3个相互垂直的方向各2小时 Frequency range: 10HZ to 55HZ and return to 10HZ, shall be transverse in 1min. Amplitude (total excursion): 1.5 mm. This motion shall be applied for a period of 2 h each of 3 mutually perpendicular axes	<±3ppm			
跌落 Drop	从750毫米高处跌落到30毫米厚的硬质木板上, 重复3次 From 750mm height to 30mm hard wooden floor, 3 times.	<±3ppm			
恒定湿热 Damp heat, constant	在温度: 40°C±2°C、湿度: 90% to 95%条件下存放7天, 常温常压下放置1小时后测试 Stored at 40°C±2°C with relative humidity of 90% to 95% for 7d, then stored at normal condition for 1 h.	<±3ppm			
低温存储 Coldness	在-55°C±3°C下存放2小时, 常温常压下放置1小时后测试 Stored at -55±3°C for 2h, then stored at normal condition for 1 h.	<±3ppm			
高温存储 heat	在105°C±3°C下存放16小时, 常温常压下放置1小时后测试 Stored at 105±3°C for 16h, then stored at normal condition for 1 h.	<±3ppm			
老化 Aging	在85±2°C下放置30天, 常温常压下放置1小时后测试 Stored at 85±2°C for 30 days, then stored at normal condition for 1 h.	<±3ppm			
热冲击 Thermal shock	-40°C±3°C(0.5h), 85°C±3°C(0.5h), 转换时间小于1min, 循环5次, 常温常压下放置1小时后测试 -40°C±3°C(0.5h), 85°C±3°C(0.5h), and changing time less than 1 min, then stored at normal condition for 1 h. 	<±5pm			
耐焊接热 Resistance to soldering heat	烙铁温度 350°C±10°C, 5S MAX The temperature of soldering iron : 350°C±10°C, 5S MAX	<±5pm			
拟制	成望生	审核	董宗全	批准	谢为亮